

46-7078 Economy Version

SMT-Stiftleisten RM 0,80 x 1,20mm stehend

SMT Pin Headers 0.80 x 1.20mm Pitch vertical

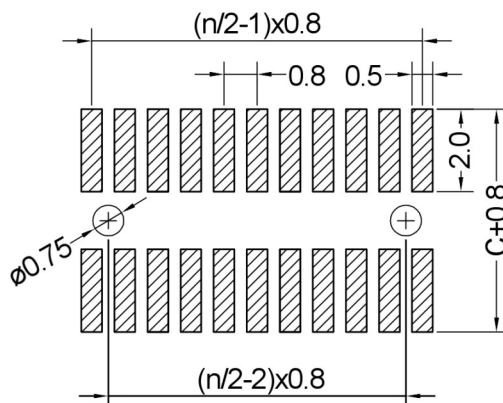
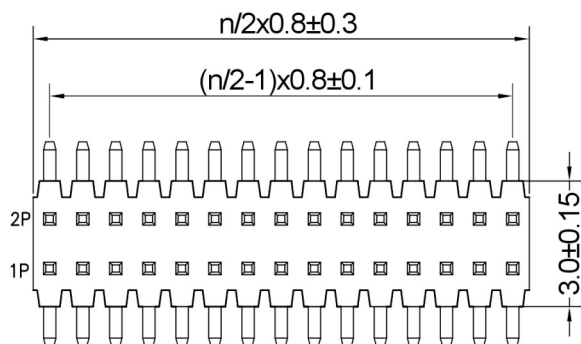
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Au über Ni
Contact Surface	Au over Ni
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
Contact Resistance	< 30 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
Test Voltage	500 V AC/DC
Nennstrom	0,75 A
Current Rating	0.75 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)
Processing	230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)

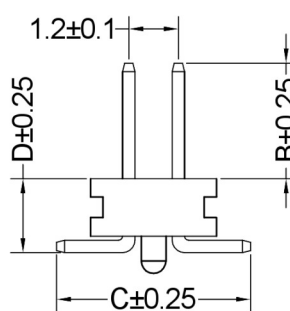
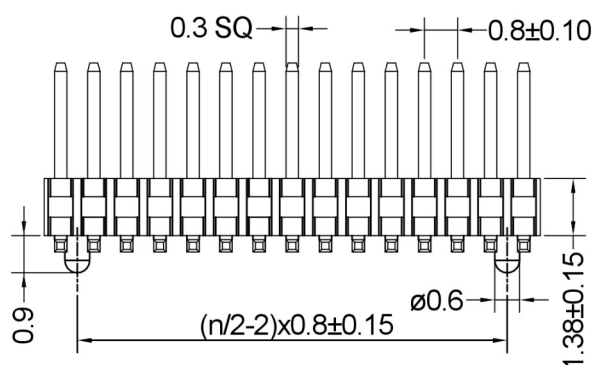


© W+P PRODUCTS

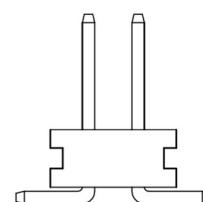
Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
46-7852



Recommended P.C.B Layout (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)



Locating Pegs
Option -10-



Without locating Pegs
Option -00-

Series

46-7078

Contacts*

016

004-100 Zweireihig
Double row

Dimensions*

11

11 B=2,80 C=4,60 D=1,80mm
99- Kundenspezifisch
Customer-specific

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

Locating Pegs*

00

00 Ohne Pos.hilfen
W/o loc. pegs
10 Mit Pos.hilfen
With loc. pegs

Packaging*

PPST

ST
PPST
PPTR

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads

PPST In Stangen mit Pick&Place-Pads / In tubes with Pick&Place-Pads

PPTR Tape & Reel mit Pick&Place-Pads / Tape & Reel with Pick&Place-Pads

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P
WE CONNECT IT

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

